



*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen.
 printed circuit board layout, components side view
 modèle de la carte imprimée, vue du côté à équiper

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
P 136	8	38

Verpackung: im Tablett
 Packaging: in tray
 Emballage: en tableau

P 136

Modular-Einbaukupplung, 8P8C (RJ-45), mit Vollschirmung, stehende Ausführung, mit Flansch, für Leiterplatten

1. Temperaturbereich	-40 °C/+85 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PE GF, V0 nach UL 94
Kontakt	CuSn, unternickelt und selektiv vergoldet
Lötkontakt	CuSn, unternickelt und verzinkt
Schirmung	CuZn, vernickelt
3. Mechanische Daten	
Kontakterung mit	Modularsteckern P 129, P 129 S

P 136

Modular chassis socket, 8P8C (RJ-45), with full shielding, upright version, with flange, for printed circuit boards

1. Temperature range	-40 °C/+85 °C
2. Materials	
Insulating body	PE GF, V0 acc. to UL 94
Contact	CuSn, pre-nickelated and selectively gilded
Solder contact	CuSn, pre-nickelated and tinned
Shielding	CuZn, nickelated
3. Mechanical data	
Mating with	modular plugs P 129, P 129 S

P 136

Embase femelle modulaire, 8P8C (RJ-45), avec blindage total, version droite, avec collet, pour cartes imprimées

1. Température d'utilisation	-40 °C/+85 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PE GF, V0 suivant UL 94
Contact	CuSn, sous-nickelé et doré sélectivement
Contact à souder	CuSn, sous-nickelé et étamé
Blindage	CuZn, nickelé
3. Caractéristiques mécaniques	
Raccordement avec	connecteurs modulaires mâles P 129, P 129 S